



RE900-04

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSOP I 16, 24, 28, 36 (0,65 mm)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- Tamaño 16,73 x 43,64 mm

Módulo-No.	Typ	Pitch	Pin	Tamaño (mm)
RE900-04	TSOP I	0,650 mm	16, 24, 28, 36	12,00 x 14,00